

华润微电子有限公司

投资者关系活动记录表

(2023 年 10 月)

证券简称：华润微

证券代码：688396

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）		
参与单位名称	10 月 27 日 20:00-21:00 中信建投 摩根士丹利 花旗環球金融 摩根大通 富安达基金 海南果实私募 峰岚资产 宁泉资产 太盟投资 浦银国际 瑞穗证券 上海璞远资产 海通资管 瑞士百达资产 北京才誉资产 宁波银行 东兴基金 西部证券 泰旻资产 深圳正圆投资 嘉实基金 上海留仁资产 上海君和资本 交银施罗德 太平资产 兴业证券 国新证券 淡水泉 上海光大证券 华创证券 华泰证券 华芯投资 西部利得 中国人寿 易米基金 中泰自营 首创证券 幻方私募 汇丰晋信基金 浙商证券 圆方资本 国寿安保基金 中华联合保险 深圳尚诚资产 上投摩根 苏州龙远投资 民生证券 太平洋保险资产 和基投资 易方达基金 国信证券 申万宏源 民生加银 首钢基金 中电科投资 上海枫池资产 圆信永丰基金 上海申银万国 中国国际金融 景顺长城 广发基金 人寿投资 方正富邦基金 国联证券 长城证券 中邮证券 管理有限公司 弘康人寿保险 国海证券		

	世豪资本 千一私募 北京源乐晟资产 创金合信 臻一资产 富达基金(香港) 西南证券 瑞银证券 润晖投资 元禾重元股权投资 Pinpoint Millennium Capital 中银基金 东海证券 华宝基金 东方财富证券 南华基金 MARCO POLO 中银理财 深圳丞毅投资 中泰证券 甬兴证券 Brilliance Capital 汇添富基金 格林基金 青岛鸿竹资产 中信证券 北京和源投资 太平资产管理 睿远基金 恒越基金 磐安投资 Artisan Partners Oasis
时间	10 月 27 日 20:00-21:00
地点	深圳（电话会议）
上市公司接待人员 姓名	李 虹 华润微电子执行董事、总裁 吴国屹 华润微电子执行董事、财务总监兼董秘
投资者关系活动 主要内容介绍	问题一：请问公司如何看待当前功率器件供给以及价格局面？ 答：2022 年下半年以来，半导体行业进入调整周期，但新能源汽车、太阳能光伏等应用仍呈现增长，因国内 8 吋、12 吋产能供应增加较快，加之前期库存较高，价格有一定压力；但长期来看，我们认为随着国内新能源车渗透率进一步提升，功率器件需求仍会稳步朝前发展。放眼全球，随着风光车储应用的普及，增量空间大，只要把高端产品做好，市场需求仍然很大。 问题二：请问公司深圳 12 吋晶圆厂的进展及主要产品？ 答：深圳 12 吋生产线按计划如期推进，10 月初主厂房封顶，计划明年年底通线。产品主要聚焦 40-90nm 特色模拟功率 IC 产品。重点产品，一是电源相关，包含电源驱动、电池保护

等，二是微控制器，包含 MCU 等。

问题三：请问公司对四季度如何展望？如何看待 2023 年前三季度业绩？

答：当前产业趋势已逐步稳定，在某些细分领域已有订单增加。然而恢复是一个缓慢过程，不是“V”型反转，预计“L”型会持续一段时间。即使在行业周期下滑比较严重的情况下，公司业绩依然保持稳定，前三季度公司实现营业收入 75.30 亿元，实现归属于上市公司股东净利润 10.56 亿元，其中公司研发投入 8.69 亿元，较上年同期增长 40.22%。如果将重庆、深圳重大项目期间成本扣除，净利润还会更高。但是我们认为研发投入是为公司长期发展奠定基础，是保持国内功率龙头地位必要途径，未来也将展现诸多重大成果。

问题四：如何展望 2024 年的终端市场？公司是否有增长目标？

答：公司团队积极拜访客户，了解市场需求情况，同时加快产品研发，我们的总体目标仍然是 2024 年要比 2023 年有所增长。实现增长取决于两方面，一是整个市场的恢复度，二是公司市场竞争力的表现，我们对公司产品很有信心。

问题五：公司 2020 年以后下游应用领域做了很多调整和优化。请问公司目前下游结构？这两年重点发力的领域，光伏等进展如何？

答：公司根据市场需求适时调整终端结构、客户结构及产品结构。近几年，我们将更多资源投向新能源汽车、太阳能光伏、工控等领域，也取得了一些成绩。公司产品与方案板块下游终端应用中，新能源领域产品占比接近 40%，加上工控、

	通信类产品占比接近 70%，消费电子占比在 30%。公司晶圆制造产能利用率目前仍然保持较高水平，同时重庆 12 吋功率半导体晶圆生产线上量，均为公司长期业绩的稳定提升打下坚实基础。随着市场进一步回暖，未来仍有进一步的发展空间。 问题六：请问公司模块产品的进展？ 答：公司模块产品包括 TMBS 模块、IPM 模块、IGBT 模块、MOS 模块，2023 年将会实现较快增长。 问题七：公司第三代半导体产品进入头部厂商，预计何时能带来可观营收？ 答：业绩贡献已经反映在今年的业绩中，今年年初汽车电子已经开始稳步上量，预计 2024 年这部分营收贡献会继续增加。 问题八：请问公司 2023 年资本开支使用情况？2024 年资本性支出预计达到多少规模？ 答：2023 年公司资本开支主要用于深圳 12 吋生产线及重庆先进功率封测基地的建设。2024 年深圳 12 吋产线仍然处于投资周期，同时公司会持续加大收购兼并力度。 问题九：请问公司 2023 年汽车主驱 IGBT 模块达到多少量级？2024 年预计实现多少量级？ 答：公司已有模块产品给客户送样认证，随着客户认证的不断推进，我们相信未来有较大增长空间。 问题十：请问公司代工方面如何做好价格与产能利用率之间的平衡？ 答：一方面公司 IDM 模式调节度较高、弹性较大；另一方面
--	--

公司代工客户粘度很高，很多重要客户均有定制化工艺开发，客户关系稳定。得益于这两方面，虽然市场价格压力很大，但我们也将继续保持产能利用率及价格的稳定。

问题十一：请问公司 2024 年的毛利率目标？

答：公司 2024 年毛利率目标是维持在 30%以上。

问题十二：公司 6 吋稼动率一直保持在比较好的水平，请问是什么原因呢？

答：公司稼动率截至三季度一直维持较高水平，6 吋线每月 23 万片产能，自用产能占 60%，代工产能占 40%。自用产能中，部分传统硅基产线改造成碳化硅和氮化镓产能，为未来提供较大增长空间，其余硅基产品仍有较强的市场竞争力；代工产能中，由于 6 吋 BCD 工艺平台极具特色，因此在市场波动情况下仍能保证较高产能利用率。

问题十三：从国内碳化硅目前规模及扩产速度看，量级与海外相比仍有较大差异。请问公司未来是否有更大的投入？

答：目前碳化硅以 6 吋为主，公司已具备较大的扩产弹性。公司一方面紧密关注客户端的需求变化，同时关注材料供应端特别是衬底材料的价格，根据这两个维度来预判碳化硅大规模放量的时间点，公司对于第三代也有明确的规划与布局。

问题十四：公司碳化硅 6 吋线相比新进入者来说，是否具有成本优势？

答：我们的成本优势体现在两个方面：其一，初始投资比新进入者具有优势，只需要购买专用设备，其他机台与 6 吋硅基产线共用；其二，跟目前较为庞大的硅基生产线共线运营，

	碳化硅与硅基共同分摊成本，具有较大的成本优势。 问题十五：参考海外厂商布局，依托原先客户积累深圳产线起量速度是否会更快？ 答：公司深圳 12 吋产线部分工艺基于现有 8 吋特色工艺平台做技术迭代和延伸，研发团队已围绕 12 吋产线开展工艺的产品设计及预研工作；同时，基于规划的工艺平台，定向引入产品团队，并购或参股产品公司，进一步做外延式发展及布局。 深圳 12 吋产线计划 2024 年底实现通线，2025 年产能爬坡，与市场上行周期相吻合，这将进一步助推上量的速度。 问题十六：请问公司如何看待第三代半导体市场关注度高但盈利能力弱的现象呢？ 答：从目前行业实际发展看，第三代半导体的盈利能力不如传统硅基产品，但第三代半导体的研发必须要做，因为这是未来技术发展的趋势。未来在电动车 800V 平台中，碳化硅也会逐渐取代 IGBT。公司持续进行产品前瞻性研发布局，加速产品迭代、技术迭代的进程，进一步加码第三代半导体的布局。 问题十七：请问公司库存情况？如何预估全年资产减值？ 答：公司三季度库存略有上升，如把原材料撇掉，在制品和产成品的库存在 2 个月左右，处于合理范围。公司按照库龄有固定比例计提资产减值。 问题十八：请问重庆 12 吋产线的产品结构及应用结构？ 答：公司重庆 12 吋产线规划产品是功率器件，包括 MOSFET
--	--

	和 IGBT，客户主要在工控、新能源、汽车电子等高端领域。 问题十九：请问碳化硅目前产能及产品结构？ 答：公司碳化硅产品 2023 年年底产能预计达到 2500 片/月，碳化硅 MOS 产品在碳化硅功率器件销售中的比例提升至 50% 以上。 问题二十：请问公司 2023 年毛利率下降的主要原因？ 答：主要来自市场下行带来的价格压力。 问题二十一：请问目前行业是否在底部阶段？四季度价格变化情况？ 答：因为目前市场需求没有明显回暖，行业仍在底部阶段，我们认为 2024 年会出现一定的复苏。同时，库存减少对客户订单有拉动作用，四季度价格方面基本企稳。 问题二十二：可否介绍下掩模业务？ 答：公司掩模产能目前 3000 片/月，掩模业务已服务国内各主要 FAB 线及众多 IC 设计公司。高端掩模项目已在建设中，一期规划产能 1000 片/月，预计在 2024 年可提供 40nm 及以上线宽的掩模代工服务。目前项目进展符合预期。
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 10 月